

プラナリゼーションCMPとその応用技術専門委員会 第131回研究会【総会と特別講演】開催のご案内

このたび、プラナリゼーションCMP専門委員会では、下記のとおり第131回研究会を開催いたします。会員各位の多数の皆様のご参加をお待ちしています。また、非会員の方のご参加も有料にて受け付けております。なお、研究会終了後、情報交換会を行いますので、是非ご参加下さい。



日時：2014年2月21日（金）13:00～

（研究会・・・13:00～17:00 7F「カトレア」、情報交換会・・・17:00～19:00 8F「スイセン」）

開催場所：プラザエフ（JR四ツ谷駅麹町口から徒歩1分）

東京都千代田区六番町15（TEL：03-3265-8111）

プログラム：

1. 開会のあいさつ（檜山委員長）
2. 平成26年（2014年）度総会（13:05～13:40）

(1) 平成25年度総括

- ・活動報告
- ・会計報告／監査報告

(2) 平成26年度活動に向けて

- ・活動方針
- ・予算案

(3) その他

3. 特別講演（13:40～17:00）／質疑応答

1) 13:40～14:25 触媒表面基準エッチングによる炭化・窒化・酸化物結晶表面の平坦化

大阪大学 工学研究科 精密科学・応用物理学専攻 教授 山内和人氏

<概要>化学エッチングに基準表面を導入することによって、表面凸部からの選択的な材料除去を実現し、高精度かつ高能率な平坦・平滑化が可能な新しい化学エッチング法を開発した。本手法では、基準表面が触媒作用を有しており、基準面上においてのみ化学反応が進行する雰囲気形成される。代表的な例として、触媒材料に白金を用い、エッチング液には純水を用いる（フッ化水素酸を用いる場合もある）。単結晶SiC、GaN、ZnOに適用した結果、これらのすべての材料において、ステップ・テラス構造を観察することができ、幾何学的かつ結晶学的に非常に高度に規定された結晶表面の創製が可能であることを明らかにした。加工メカニズムや加工装置の構成、様々な材料への応用例について述べる

.....

14:25～14:40 コーヒーブレイク

.....

2) 14:40～15:25 メモリ混載LSIにおけるCMP技術の役割と課題

ルネサスエレクトロニクス株式会社 生産本部 プロセス技術統括部 泰地稔二氏

<概要>メモリとロジックを同一チップに搭載するメモリ混載技術は、システムLSIを支える重要な技術として浸透している。ここではメモリ混載LSI製造におけるCMPの役割や要求、および課題について述べる。また、次世代メモリ混載技術に要求されるCMP技術についても紹介する。

3) 15:25～16:10 Last Paradigm Shift 10 -The future of semi-conductor device and CMP technologies-

株式会社 荏原製作所 精密・電子事業カンパニー プレジデント 辻村 学氏

<概要>これまでに、「パラダイムシフト45」および「パラダイムシフト20」において、スケールアップ、ウェーハサイズ拡大、3次元実装などに関する技術的障壁について議論してきた。ここでは、「最終パラダイムシフト10」と題して10nmスケールアップ以降のCMPを含む技術課題について議論したい。スケールアップにおける10nmの課題、450mm以降のウェーハサイズ(10cm?)の提案、TSVの穴径10μmなど、サイズにおける10を共通キーワードとして、将来の半導体デバイスとCMP技術に何が起るのかを俯瞰する。

4) 16:10～16:55 電子デバイスの新たな可能性～スマート社会に貢献するインフラチップが今後のキーワード

株式会社 産業タイムズ社 代表取締役社長 泉谷 渉氏

<概要> 概要半導体産業は1時的には踊り場状態にあるが、社会を支えるインフラとしての重要性はさらに高まっている。20年後には世界のエネルギー消費量は現在の2倍にふくれあがるため、どうあっても省エネがすべての必要条件になる。また、人口増は20億人以上が見込まれ医療産業の一気拡大が不可欠になる。さらには、ウェアラブルなモバイルが次のITの必須条件となる。今回はこうした社会変化に対応する電子デバイスの可能性を最新レポートする。

4. その他連絡事項 (16:55~17:00)
 5. 閉会のあいさつ

17:00~ (情報交換会・懇親会)

■参加費:

1. 企業会員: 無料 (年会費 100,000 円)
2. 官学会員: 無料 (年会費無料・要登録)
3. 非会員: 30,000 円 (今回の研究会のみの参加費)
 ※ご入会検討でお試し参加される場合, 初回のみ一人様 15,000 円でご参加頂けます.
 ※参加費にはプロシーディング代, 懇親会費が含まれます.
 ※人数確認のため会員方も必ず事前に申込書の提出をお願い致します.
 ※準備の都合上, 懇親会ご参加有無について必ず記入をお願いいたします.

お申込み・お問合せ先: 「プラナリゼーションCMP 専門委員会」事務局 (三上) 行き
 TEL: 03-5117-2225, FAX: 03-5117-2223, E-mail: mikami@global-net.co.jp

2014年2月21日(金)開催 第131回研究会 参加申込書

会員 / 一般 (いずれかにチェックしてください)

氏名			
勤務先・所属			
いずれかに✓してください	研究会		情報交換会 (懇親会)
	<input type="checkbox"/> 参加	<input type="checkbox"/> 不参加	<input type="checkbox"/> 参加 <input type="checkbox"/> 不参加
連絡先	住所		
	TEL		FAX
	E-mail		